



可填充生瓷片或烧结后的陶瓷基板

可填充0.05mm-1mm孔径

采用挤压式掩膜直填工艺，确保精准填孔，适合高深宽比填孔

气压挤压技术可自然排出孔内空气，实现更致密填充

优异的流体动力性能，避免传统丝网印刷工艺中常见的空气滞留问题

显著提高填孔效率和质量，避免重复印刷需求

可选配自动上下料

PTC填孔机

VM12003挤压式氮化铝填孔机是一款用于多层陶瓷器件小孔金属化工艺的挤压式填孔设备。适用于氮化铝、氧化铝、氧化锆等材料体系的陶瓷基板、陶瓷管壳、静电吸盘、探针卡等行业应用。通孔的浆料通过一个掩膜直接进入到生瓷或熟瓷通孔中，填孔浆料是受空气压力将浆料被挤压进孔中，自然地排除孔里的空气并将其填满，良好的流体动力性能使其优于丝网印刷时因重复印刷而滞留在通孔里的空气。

VM12003挤压式填孔机适用于浆料粘度高、通孔小、深宽比高的导电填充。设备稳定，精度高，简洁易用，适合企业、高校、研究院所使用。

参数

填孔压力	0 - 100 psi (0.8 MPa)
循环时间	可调(标准20 s)
注射时间	0.1 - 99 s
填孔孔径	最小0.05 mm
对位系统	CCD显微镜
工作台	4 轴可调
工作台精度	± 0.0025 mm
浆料粘度	500,000cps
认证	CE



VM12003

• 同时适用生瓷片或烧结后的陶瓷基板

• 与丝网印刷相比，深宽比更高

• 最小填充孔径50μm

• 双十字高精度视觉对位

• 浆料均匀填充，通孔无残留空气

• 掩模快速更换装置

• 快速填充

• 简洁易操作